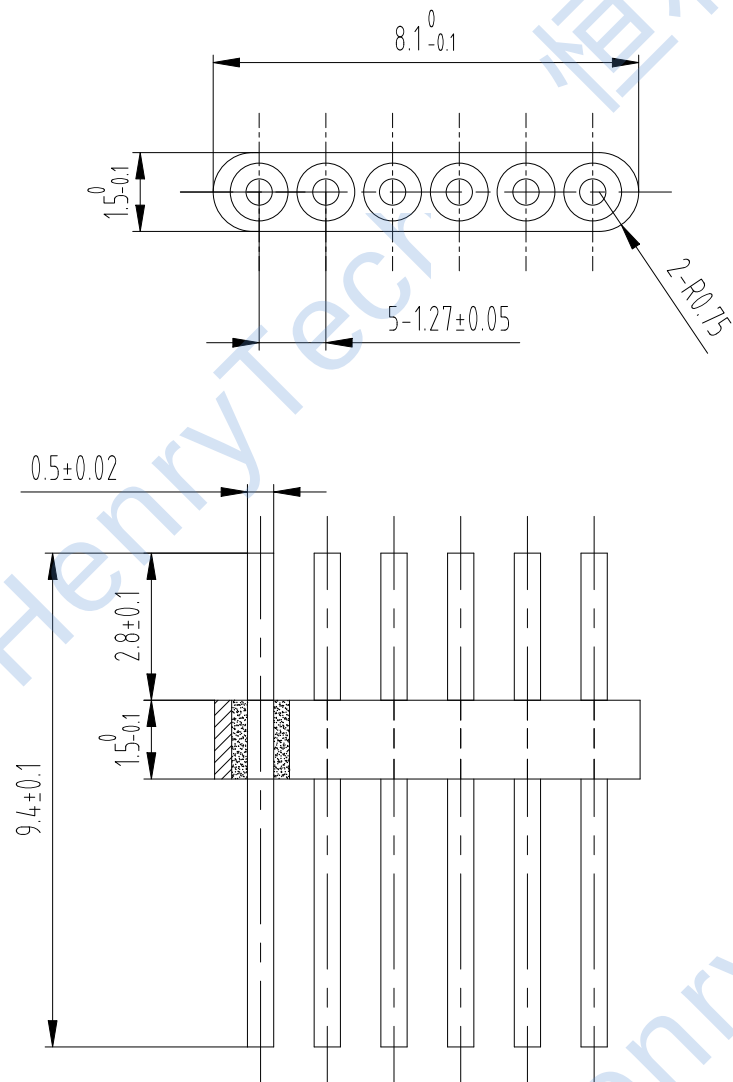




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega@500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013\times 10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65\sim+155$
6. 镀层厚度： $\geq 1.27\mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP6-0.5-1.27(9.4-2.8)
M

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	M		标准化	
审核				
工艺			日期	

图样标记	重量	比例
		7:1
共 页	第 页	